证券代码：300567　　证券简称：精测电子　　公告编号：2025-109

武汉精测电子集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	精测电子	股票代码	300567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘炳华	程敏	
电话	027-87671179	027-87671179	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号	武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号	
电子信箱	liubinghua@wuhanjingce.com	chengmin@jcdz.cc	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,381,084,102.09	1,121,042,989.41	1,121,042,989.41	23.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,666,361.74	49,827,877.48	49,827,877.48	−44.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−25,441,206.48	−3,019,868.53	−3,019,868.53	−742.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−459,636,503.32	−197,662,748.59	−197,662,748.59	−132.54%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	0.18	−44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.21	0.21	−33.33%
加权平均净资产收益率	0.76%	1.37%	1.37%	−0.61%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,021,206,462.88	10,076,306,760.49	10,076,306,760.49	−0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,803,312,837.45	3,463,816,767.37	3,463,816,767.37	9.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年度开始执行《会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。本报告期追溯调整2024年半年度合并报表相关项目，调增2024年半年度营业成本26,235,491.13元，调减2024年半年度销售费用26,235,491.13元，不涉及上述主要会计数据和财务指标的调整。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
彭骞	境内自然人	25.06%	70,112,000	52,584,000	质押	33,544,600
陈凯	境内自然人	8.05%	22,529,813	22,529,813	不适用	0
胡straw	境内自然人	2.51%	7,032,108	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.13%	5,956,300	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—广发上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.08%	5,819,805	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—广发中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.82%	5,091,126	0	不适用	0
全国社保基金一八组合	其他	1.74%	4,854,806	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.70%	4,768,968	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	其他	1.58%	4,429,987	0	不适用	0
武汉精测投资中心（有限合伙）	其他	1.06%	2,958,691	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	精测转2	123176	2023年03月02日	2029年03月01日	127,551.3	0.60%001

注：001第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.30%	58.42%
流动比率	1.88	1.61
速动比率	1.15	1.05
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.94	2.79
EBITDA全部债务比	6.54	4.40
利息保障倍数	2.44	1.45
现金利息保障倍数	−10.73	−4.65

三、重要事项

（一）主营业务

公司主要从事半导体、显示及新能源检测系统的研发、生产与销售。公司目前在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备和自动检测设备（ATE）等。在显示领域的主营产品涵盖LCD、OLED、Mini-LED、Micro-OLED、Micro-LED等各类显示器件的检测设备，包括信号检测系统、AOI光学检测系统、OLED调测系统、自动化装备集成产品、AI检测软件与系统以及智能和精密光学仪器等。在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备，主要用于锂电池电芯组装配和检测环节等，包括锂电池切叠一体机、CT&XRAY无损检测机、化成分容系统、CIR组装配线、锂电池视觉检测系统和BMS检测系统等。

本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

（二）主要经营情况

报告期内，公司紧抓半导体设备国产化替代重要机遇期，持续夯实半导体量检测产品的国内行业领先地位，布局产业链上游核心部件，同时进一步加大了对先进制程领域（14nm及以下）的研发投入和产品布局，公司半导体领域呈爆发式增长，半导体领域营业收入56,259.20万元，较上年同期增长146.44%；净利润15,829.79万元，相较于去年同期增长2,316.39%；其中归母净利润7,283.45万元。公司膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品均处于国内行业领先地位，竞争优势明显。公司14nm先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备已正式交付客户，28nm制程工艺节点的明场缺陷检测设备已在客户端完成验收，半导体前道量测领域部分主力产品已完成7nm先进制程的交付及验收，目前更加先进制程的产品正在验证中。先进制程产品占公司整体营收和订单的比例不断增加，预计后续会成为公司业绩的核心驱动力。半导体领域目前已成为公司业绩核心，公司对整个半导体领域行业以及公司在该领域持续快速增长充满信心。

平板显示行业正逐渐走出周期性底部，LCD大尺寸、超大尺寸预计仍存在扩线投资需求；OLED技术日趋成熟，应用场景和销售占比逐步增加。截至本报告披露日，公司显示领域在手订单约14.40亿元，相较《2024年年度报告》披露日（2025年4月24日）在手订单7.64亿元，环比增长88.48%，公司在显示领域订单得到大幅增长。后续随着消费领域头部客户IT类产品逐步使用OLED屏幕带来的行业风向标，以及国内龙头企业京东方G8.6 OLED项目的投建，中大尺寸OLED的新建投资预计会持续进行，公司在显示领域订单情况将得到持续性改善。报告期内，公司新能源领域归母净利润亏损3,090.05万元，针对新能源领域持续亏损的不利局面，公司将进一步优化、调整业务结构，聚焦半导体等优势领域。

本期投资收益相较于去年同期减少4,025万元（公司联营企业湖北星辰主要布局先进封装领域、子午亦东主要布局半导体零部件领域，目前均处于快速投入期，报告期内湖北星辰投资收益相较于去年同期减少2,174万元、子午亦东投资收益相较于去年同期减少1,551万元）。另外，受前期显示领域市场需求较为疲软，市场竞争加剧以及客户下单节奏等相关因素的影响，截至《2024年年度报告》披露日（2025年4月24日）公司在显示领域在手订单仅为7.64亿元，在手订单不足直接导致报告期显示领域销售收入下降，报告期内显示领域实现销售收入67,070.68万元，相较于去年同期下降13.54%；归母净利润2,775.07万元，相较于去年同期下降66.08%。最后，为了应对半导体、显示领域激烈的人才竞争态势，进一步激励员工，公司对现有人才梯队进行了深度优化和升级，积极扩充以研发为主的高端人才、研发、销售以及管理费用等均有一定幅度增加。受上述多方因素叠加的影响，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润出现一定程度的下滑。

报告期内，公司实现营业收入138,108.41万元，同比增长23.20%；实现归属于上市公司股东的净利润2,766.64万元，同比下降44.48%；报告期末公司总资产为1,002,120.65万元，较期初减少0.55%；归属于上市公司股东的净资产为380,331.28万元，较期初增长9.80%。截至本报告披露日，公司取得在手订单金额总计约36.09亿元，其中半导体领域在手订单约18.23亿元、显示领域在手订单约14.40亿元、新能源领域在手订单约3.46亿元，公司显示领域订单得到明显好转，半导体业务已成为公司经营业绩核心。

（1）半导体量检测业务

报告期内，随着电动汽车产业、大数据及人工智能的快速发展，对芯片（特别是高端算力芯片）产出的需求量与日俱增，国内对半导体设备需求强烈，后续仍将有比较长的持续增长周期。且伴随着芯片领域国际竞争形势变化剧烈以及受中美贸易摩擦升级的影响，作为电子信息关键元器件的半导体产业链的完整性和安全性已经上升至国家和行业战略高度，半导体设备国产化替代进入重要机遇期。公司聚焦的半导体检测设备领域，特别是前道量测领域，国产设备供给率较低，替代空间广阔，公司的多款主力产品已获诸多一线客户认可，并取得良好的市场口碑。与此同时，公司还在加紧其余核心产品的研发、认证以及拓展。

目前公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，逐步形成在半导体检测前道制程、先进封装和后道检测的全领域量检测技术产品布局。公司子公司武汉精鸿主要聚焦自动测试设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），老化（Burn-In）产品线在国内一线客户实现批量重复订单、CP（Chip Probe，晶片探测）/FT（Final Test，最终测试，即出厂测试）产品线相关产品已取得相应订单并完成交付。在晶圆外观检测设备领域，公司于2019年开始晶圆级产品的立项，现已成功推出W1200系列与WST1200系列产品并交付封测头部客户。此外，公司自主研发的探针卡产品系列产品也已实现量产。

公司子公司上海精测主要聚焦半导体前道量检测设备领域，掌握光谱散射测量、光学干涉测量、光学显微成像、电子束/离子束成像、电学测试等关键核心技术，致力于半导体前道量测检测设备的研发及生产，设备广泛应用于硅片加工、晶圆制造、科研实验室、第三代半导体四大领域。

公司半导体量检测产品布局情况详见下表：

公司膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品均处于国内行业领先地位，竞争优势明显。其中膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备已取得国内先进制程重复性订单；半导体硅片应力测量设备验证通过且已取得国内多家头部客户重复批量性订单；明场光学缺陷检测设备已取得多台正式订单，其中先进制程明场缺陷检测设备已正式交付客户，28nm制程工艺节点的明场缺陷检测设备已在客户端完成验收；有图形暗场缺陷检测设备等其余储备的产品目前正处于研发、认证以及拓展的过程中。依托技术持续突破、产品成熟度以及品牌认可度不断提升，公司半导体检测业务开拓迅速，订单以及销售收入持续快速增长。

现阶段，公司半导体领域订单主要来源于前道量检测领域，前道量检测领域订单占半导体领域订单九成以上，后道检测等领域尚处于市场培育阶段，占公司半导体领域营收和订单的比例较低。报告期内，公司在整个半导体板块实现销售收入56,259.20万元，较上年同期增长146.44%；净利润15,829.79万元，相较于去年同期增长2,316.39%；其中归母净利润7,283.45万元。截至本报告披露日，公司在半导体领域在手订单约18.23亿元，占公司整体订单50.51%。半导体领域已成为公司经营业绩的核心支撑。

伴随着国际晶圆厂工艺节点的不断迭代，国内下游晶圆制造企业的工艺也在同步向更先进制程不断发展，对检测设备的灵敏度、可适用性及稳定性等提出了新的挑战。公司顺应半导体市场发展趋势，针对下游晶圆制造企业半导体制造工艺节点的升级需求对公司半导体检测设备进行技术迭代，公司进一步加大了对先进制程领域（14nm及以下）的研发投入，公司14nm先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备已正式交付客户，其他部分主力产品已完成7nm先进制程的交付及验收，目前更加先进制程的产品正在验证中。先进制程产品占公司整体营收和订单的比例不断增加，预计后续会成为公司业绩的核心驱动力。

同时，为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求，公司积极对先进封装技术进行战略布局，通过增资湖北星辰，深化与湖北星辰等核心客户的战略合作与绑定。现阶段，湖北星辰已建成国内领先的12英寸集成电路先进封装研发线，核心工艺已全面贯通，可为客户提供一站式先进封装成套解决方案。目前，已进入客户导入阶段。同时，根据市场需求，正在部署建设研发线二期项目。公司在半导体行业的布局从前道量测设备拓展至半导体制造封装产业链，有利于公司抓住数据中心、超算、AI产业快速发展的历史机遇，同时促进公司半导体业务的增长，对公司的长远发展具有重要意义。未来，公司将继续坚持以自主创新为核心、以产学研合作为两翼，通过全线自研软硬一体"光机电算软"核心技术平台，继续深耕集成电路领域，面向世界科技前沿，加大研发投入，依托武汉、上海、北京三大半导体研发生产基地协同发力，逐步形成在半导体检测前道制程、先进封装和后道检测的全领域量检测技术产品布局，致力于打破目前集成电路高端检测设备被国外厂家垄断的局面，不断推进、引领半导体检测设备国产替代化进程。

（2）平板显示检测业务

报告期内，公司在显示领域总体经营情况平稳有序，显示领域实现销售收入67,070.68万元，相较于去年同期下降13.54%；归母净利润2,775.07万元，相较于去年同期下降66.08%。通过持续的高强度研发投入，动态优化调整产品结构，全面提升精益生产管理能力，公司在显示领域的整体竞争能力得到了进一步增强。报告期内，公司显示领域毛利率43.09%，较去年同期提升1.62%，较2024年毛利率水平提升4.73%。截至本报告披露日，公司在显示领域在手订单约14.40亿元，相较《2024年年度报告》披露日（2025年4月24日）在手订单7.64亿元，环比增长88.48%，公司在显示领域订单得到大幅增长。

2025年，平板显示行业正逐渐走出周期性底部，LCD大尺寸、超大尺寸预计仍存在扩线投资需求；OLED技术日趋成熟，应用场景和销售占比逐步增加，后续随着消费领域头部客户IT类产品逐步使用OLED屏幕带来的行业风向标，以及国内龙头企业京东方G8.6 OLED项目的投建，中大尺寸OLED的新建投资预计会持续进行。公司将牢牢把握显示产业上述市场机遇，继续保持在显示领域的高研发投入，不断优化调整产品结构，持续提升精益生产管理能力，加大毛利率相对较高的新产品市场投入，公司对整个显示检测领域行业以及公司在该领域保持稳健发展充满信心。

公司在新型显示以及智能和精密光学仪器领域取得明显进展。公司在智能和精密光学仪器领域进一步探索、深化、整合显示颜色测量技术、高速数据处理技术和光电设计等核心技术和能力的同时，构建全信息化的运营管理机制、信息化自动化生产制造体系，为后续的软件系统化、硬件模块化以及该领域的快速发展奠定了坚实的基础。公司在智能和精密光学仪器领域，主力产品色彩分析仪、单点光谱仪、光谱共聚焦仪、成像式闪烁频率测仪、成像式亮度色度仪、AR/VR测量仪等核心产品打破国外垄断，陆续取得研发、产品突破，获得了国内外核心客户重复批量订单，现阶段已实现较大规模的销售，未来将对显示领域的快速发展提供重要的支撑。

公司持续聚焦新型显示产业革命性机遇，深化AR/VR赛道全产业链深度布局，与全球AR/VR行业龙头达成战略协同，构建起覆盖"核心器件-模组-整机"的全制程检测解决方案。在AR领域，公司在Display Engine光引擎、Eyepiece目镜模组及FATP整机组装制程检测环节保持技术代差优势，持续收获重复订单；在VR领域，公司依托自主知识产权的光学检测系统，持续获得全球TOP客户Micro OLED微显示及Pancake光学模组全流程检测设备订单，继续深耕该领域。不仅如此，公司积极探寻新的合作增长点，不断拓展合作边界，正在积极推进与海外头部客户基于Waveguide光波导检测需求的项目合作，为公司未来业务增长注入强劲动力。这一系列丰硕的合作成果，进一步稳固了公司在头显检测设备领域的技术领先地位。

未来公司将继续加大在新型显示领域的研发力度，深入拓展国内外市场，与国内外头部战略客户形成更紧密、更深层的合作关系，为未来几年迎来该领域全面爆发式增长奠定坚实基础。随着新型显示技术的进一步突破以及商业化应用进程不断加快，公司在显示领域的综合竞争能力将进一步跃升，公司对该领域整个显示检测领域行业以及公司在该领域持续稳健增长充满信心。

（3）新能源检测业务

报告期内，锂电池装备制造行业市场竞争加剧、电池厂商验收周期延长，针对新能源领域持续亏损的不利局面，公司一方面优化并调整业务结构，削减低效赛道，克服行业内卷，营业收入显著提升；另一方面，公司适度下调在新能源领域的研发投入，将节省资源向公司优势业务倾斜。报告期内，公司新能源领域营业收入11,972.94万元，较去年同期提升27.32%；研发投入2,315.52万元，较上年同期下降26.81%。受收入结构变动、市场竞争加剧、动力锂电设备技术工艺尚处于磨合期等因素影响，客户整体验收节奏放缓。截至本报告披露日，公司在新能源领域在手订单约3.46亿元。

（4）研发持续高投入，不断拓展应用领域

报告期内，公司继续保持研发投入强度，研发投入31,999.90万元，较上年同期增长6.31%，占营业收入23.17%；其中，半导体检测领域研发投入16,650.78万元，较上年同期增加24.37%；显示检测领域研发投入13,033.60万元，较上年同期下降3.80%；新能源领域研发投入2,315.52万元，较上年同期下降26.81%。

截至2025年6月30日，公司已取得2,486项专利（其中1,154项发明专利，928项实用新型专利、404项外观设计）、384项软件著作权、57项软件产品登记证书、83项商标（其中国际商标26项）。

随着研发投入持续转化为经营成果，公司核心竞争力将进一步增强，行业领先地位也将更加稳固。未来，公司将保持高强度研发投入，通过开放创新与资源整合，在平板显示领域巩固既有技术优势，重点突破新型显示技术，并向产业链上下游延伸，持续提升竞争力。同时，公司继续加大在半导体检测设备领域的研发力度，加速新技术、新产品的孵化落地，推动订单规模与销售收入持续增长。半导体检测业务已成为公司新的业绩增长点，未来有望通过持续创新，成为公司高质量增长的重要引擎。

（5）持续提升信息披露质量，强化投资者关系

上市以来，公司连续多年在深圳证券交易所信息披露考核等级中取得佳绩。报告期内，公司赓续优秀的工作传统，以更高标准夯实合规根基：一方面持续强化业务学习，严格履行信息披露义务；另一方面，在合规框架内高效回应互动易投资者提问，举办多场次的机构投资者交流会、业绩说明会，保持投资者关系电话畅通，多维度搭建透明、及时的沟通桥梁。通过系统化、常态化的投资者关系管理，公司进一步提升了运作透明度，切实履行对资本市场的承诺，巩固了专业、规范的公众形象。

证券代码：300101　　证券简称：振芯科技　　公告编号：2025-055

成都振芯科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	振芯科技	股票代码	300101
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈思莉	张爽	
电话	028-65557625	028-65557625	
办公地址	成都市高新区高朋大道1号	成都市高新区高朋大道1号	
电子信箱	touzibu@corpro.cn	touzibu@corpro.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	483,126,015.76	354,096,725.47	36.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,553,496.39	47,951,920.79	36.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,808,665.25	30,053,651.39	82.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−6,246,871.08	3,553,868.43	−275.78%
基本每股收益（元/股）	0.1154	0.0849	35.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1150	0.0849	35.45%
加权平均净资产收益率	3.61%	2.76%	增加0.85个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,901,055,630.83	2,914,221,101.19	−0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,799,947,673.35	1,782,134,517.28	1.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,300（户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	29.21%	165,860,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—鹏华上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	4.51%	25,614,444	0	不适用	0
刘静	境内自然人	2.27%	12,863,500	0	不适用	0
上海飞科电器股份有限公司	境内非国有法人	1.59%	9,012,970	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—华夏上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42%	8,052,903	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	5,200,801	0	不适用	0
关海果	境内自然人	0.88%	4,984,600	0	不适用	0
张樱姝	境内自然人	0.77%	4,377,600	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—中证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	4,199,500	0	不适用	0
泰康资产—众合投资（北京）管理有限公司—泰康资产—泰康资产—泰康资产